

# 东莞回收ST先科IC芯片

产品名称	东莞回收ST先科IC芯片
公司名称	深圳市东城电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	全国各地都可回收
联系电话	158****7035 158****7035

## 产品详情

该封装是美国Motorola公司开发的，首先在便携式电话等设备中被采用，随后在个人计算机中普及。初，BGA的引脚（凸点）中心距为1.5mm，引脚数为225。现在也有一些LSI厂家正在开发500引脚的BGA。BGA的问题是回流焊后的外观检查。美国Motorola公司把用模压树脂密封的封装称为MPAC，而把灌封方法密封的封装称为GPAC。

### 2、C-（ceramic）

表示陶瓷封装的记号。例如，CDIP表示的是陶瓷DIP。是在实际中经常使用的记号。

TPS79601DCQR

REG1117A-2.5

UPC24M06AHF-AZ

ADP3339AKCZ-3-RL7

LM2937IMPX-12/NOPB

TPS64203DBVT

TL1963A-18DCQR

INA2180A1IDGKR

TLV62569PDDCR

TPS2546RTER

ACFM-2113-TR1

TPS79901QDRVRQ1

MP1601CGTF-Z

MP1658GTF-Z

MP1662GTF-Z

TCA9535RTWR

TXS0108ERGYR

BQ25619RTWR

DRV8835DSSR

TPS54335ADDAR

TPS7B4254QDDARQ1

TPS7A1601QDGNRQ1

TPS25944LRVCR

MMA8453QR1

TJA1044GT/3Z

TJA1057GT/3J

TJA1042TK/3/1J

TJA1029TK,118

TJA1048TK,118

TJA1051TK/3,118

AD8603AUJZ-REEL7

ADUM1100ARZ-RL7

ADM3251EARWZ-REEL

PIC32MX795F512L-80I/PT

PIC32MX695F512L-80I/PT

TJA1046TKZ

TJA1028TK/5V0/20/1

TJA1043TK/1Y

MPVZ5004GW7U

MCIMX6U6AVM10AD